

无压烧结银 加压烧结银 低温烧结银

产品名称	无压烧结银 加压烧结银 低温烧结银
公司名称	善仁（浙江）新材料科技有限公司
价格	320000.00/件
规格参数	品牌:善仁新材 颜色:银色 产地:上海
公司地址	嘉善县姚庄镇宝群东路159号 - 2二层
联系电话	021-54830747 13611616628

产品详情

无压烧结银 加压烧结银 低温烧结银

善仁新材推出高可靠烧结纳米银胶，产品可以用在SiC，GaN等第三代半导体的封装。也可以用于传统的SIP封装以及大功率器件的封装。

烧结型纳米银胶成为大功率芯片封装的**选择。

善仁新材开发的耐高温低温烧结银AS9300具有以下特点：

- 1 低压或者无压烧结
- 2 低温工艺：烧结温度可以在180度
- 3 高导热率：导热率可达100W/mK以上
- 4 高导电率：体阻低至 8×10^{-6}
- 5 耐候性好：-55-220 ° C
- 6 和其他焊接工艺相比，可提高功率密度，降低系统总成本
- 7 无铅环保：无卤配方
- 8 以膏状形式供应：便于操作
- 9 使用寿命长：是其他焊膏使用寿命的5-10倍

